

产品概述

该芯片是新一代高规格蓝牙音频 SoC 芯片，内置高性能 HiFi 5 DSP 和 NPU，以支持复杂的多麦克风风上行降噪算法和关键字唤醒，同时兼顾低功耗。集成 Hybrid ANC，可支持高带宽、深降噪的耳机应用。可提供丰富的接口，集成度高，适用于高级 TWS 降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音 AI 能力的低功耗产品。

优势特性

- 支持BT/BLE 5.3双模协议栈；
- 集成高性能双RISC-V CPU，HiFi 5 DSP和NPU；
- 采用Hybrid（FF+FB）混合式ANC主动降噪设计；
- 支持多Mic+AI通话降噪，显著提升通话体验；
- 平均3.x mA的超低功耗，支持更长的续航时间；
- 支持W-TWS+模式，完全无感智能主从切换；
- 支持多链接机制，一对耳机双设备连接；

应用领域：



TWS耳机

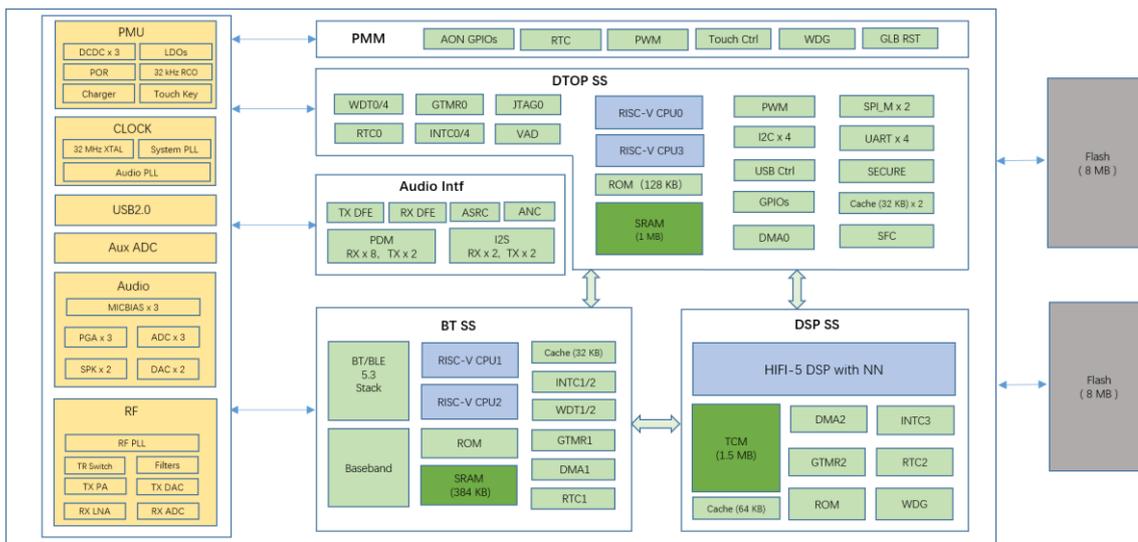


游戏耳机



蓝牙音箱

产品框图



版权所有 © 重庆物奇微电子有限公司 2023。保留一切权利。未经版权所有人的书面许可，本文件的任何部分不得转载。

免责声明

由于在方法、设计和制造方面的不断进步，本文件的内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文件仅作为使用指导，重庆物奇微电子有限公司对使用本文件所产生的任何错误或损害不负任何责任。